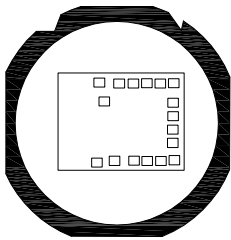


江苏芯丰集成电路封装压焊图

图号: 314BD005

版本 A.0

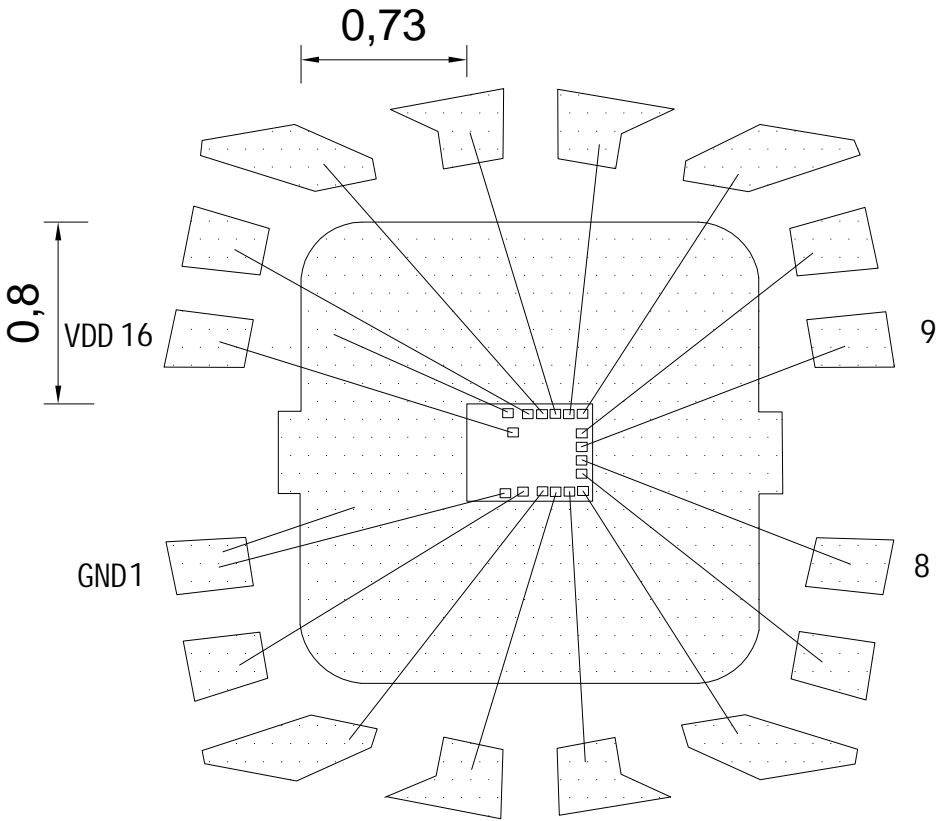
贴片方向（芯片与片环方向示意图）



框架传输进料方向  
第一个孔为椭圆孔



备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）



顶针		点胶方式	
单顶针	多顶针	点胶	画胶
	/		/

产品型号 (Product Type) :	YL9000P	线材直径 (Wire Diameter) :	银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)	300±10um
芯片名称 (Die Name) :	HS5122	压焊点尺寸 (Pad Opening) :	50.35×50.35um	装片胶 (Epoxy)	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸: (Die Size) :	0.5548×0.4332mm	最小压焊间距 (Min Pitch) :	59.85um		S610C(导电胶)
封装形式 (Package Type):	SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)	先焊线 (Wire Bond Start):	PIN1	塑封料 (Molding Compound)	GR710GN
引线框 (Lead Frame) :	SOP16L(12R)(80×80)	焊线总数 (Quantity of Wire) :	18		/
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):	雾 锡	最长线长(Length of longest Wire):	1.48mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
晶圆尺寸 (Wafer Size) :	/	顶层铝厚 (Top Al Thickness):	1um(3层)	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
吸嘴 (suction nozzle)	RR10×10	切割道 (Cutting Way)	60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
拟制 Prepared by	钱培丽 2022.7.28	审核 Checked by		批准 Approved by	